



情報検索委員会

CPCの最新状況とWIPO訪問団報告

6/23 関東部会 6/25 関西部会



CPCの最新状況

- ◆ 中国、韓国の付与状況
 - 2015年1月には「75分野の分類に付与」とアナウンスされているが、各 庁が付与したCPCは一部の公報のみ
- ◆ USCの廃止状況
 - 2015年3月には、「まもなくUSPCが付与された公報は発行されなくなる」とアナウンスされているが、現状(2015年5月末時点)は、USCは付与されている
- ◆ PCT案件の付与状況
 - 受理官庁別(5極+WIPO)の付与率は95%以上
 - 日本語PCT出願案件にも付与されている





今回の訪問までの経緯

- ◆ 2012, 2013年: EPO PIC に参加 (Patent Information Conference)
 - PDGのWG "IMPACT" と連携開始 (Impact of patent laws on documentation)
 - EPO·USPTOの特許分類責任者と意見交換

CPCとFIが乖離する問題を提起

- ◆ 2014年: PDGから65th IMPACT meeting に出席要請 EPO East meets West 2014 と併せて参加
 - CPCとFI/Fタームの調和実現に向けて、そのメリットをPDG及びEPOに対して、日本特許ユーザーの代表としてプレゼンテーション

CPCとFIの調和を推進





2015年 訪問内容

- ◆ 特許分類調和に対するWIPOへの提言
 - 次回IPC改正によるCPCとFIの調和を提言
 - ファミリー付与観点を考慮した分類コンコーダンス機能の改善を要望
- ◆ PDG IMPACT Meetingへの参加
 - CPC関連研究の進捗報告
 - 分類調和へ向けたWIPOへの提言紹介
 - EPO分類担当者にCPCの最新状況を確認
- ◆ ip-search 訪問
 - スイス特許庁の調査部門であるip-searchにて、サーチスキルをヒアリング





WIPO訪問

◆ 概要

- 日程、場所: 4/20 @ WIPO本部, Geneva

- 参加者:事務局長補・グローバルインフラ担当

高木氏

: 分類担当者

Antonios Farassopoulos 氏、Ning Xu 氏

◆ 内容

- 次回IPC改正によるCPCとFIの調和を提案
- ファミリー付与観点を考慮した分類コンコーダンス機能の改善を要望

◆ 成果

- 調和への進捗は、各庁の意向が合わないことも多々あり遅れている。その ためコンコーダンスの改善は前向きに取り組みたい
- 委員会の研究成果である「テーマコード⇔CPC対応表」をWIPOに提供して、WIPOのコンコーダンス機能の改善に協力していく





PDG IMPACT meeting 2015

◆ 概要

- 日程:4/16、17

- 場所: Hotel Russell, London

- 参加者: 41名 PDGメンバ、各国特許庁、各ベンダ

◆ 内容

- CPCとFIを対比させた俯瞰的な分析結果を紹介。IPCをベースとすれば、その 差は半分以下のため、スーパーセットの候補として最適と考える旨を主張ファミ リー付与観点を考慮した分類コンコーダンス機能の改善を要望
- JIPAのCPC研修の教材を Nelson das Neves氏 (EPO)に紹介

◆ 成果

- CPC分類担当者とのパスを構築。今後もコンタクトを取り最新情報を取得する <コメント>

JIPAがCPCの研修をしていることが大変興味深い。日本のCPCユーザーの声を直接聞ける機会なので、研修に参加したい。





ip-search 訪問

◆ 概要

- 日程、場所: 4/21 @ip-search, Bern

- 参加者: Yvonne Schumacher氏 (IEG)

Markus Funk氏, Jochen Spuck氏 (ip-search)

内容

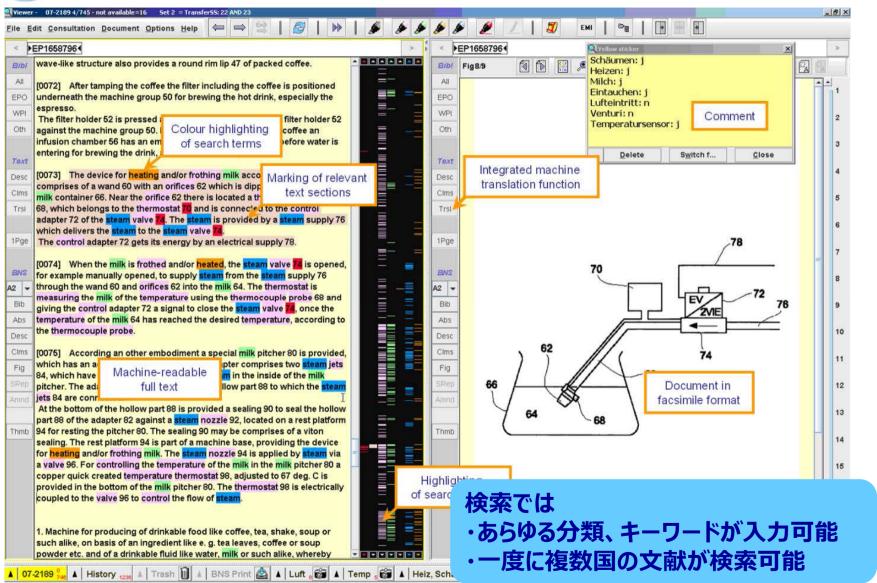
- ip-searchの紹介。特にEPO審査間端末を利用した世界検索のデモ。
- 欧州言語(仏、独語)でのサーチ能力、読込能力は高いと思われる。







Epoque-net(公報確認画面)







以下、プレゼンテーション抜粋





JIPAの発表内容(2014年度)

- ◆ CPCとFIの階層構造の比較
 - FIが優位(分類数が多い)の技術分野

< 付録 3> H01L21/302の分析結果 (半導体装置のエッチング技術)

CPC 分類数 -> 4 H01L 21/302 • • • • to change their surface-physical characteristics or shape, e.g. etching, to change their surface-physical polishing, cutting [2] H01L 21/302 characteristics or shape, e.g. etching, polishing, H01L 21/302 100 · · · · · Plasma etching · · · · · · Plasma etching systems H01L 21/302 101 Mechanical treatment, e.g. grinding, H01L 21/304 polishing, cutting {(H01L 21/30625 takes HO1L 21/302 101 B Parallel flat plate systems (including capacitive coupling type, RIE, two-frequency precedence)} Mechanical treatment, e.g. grinding, HO1L 21/302 101 C Inductive coupling systems (incluidng TCP (R), ICP, helicon wave systems) H01L 21/3043 polishing, cutting {(H01L 21/30625 takes HO1L 21/302 101 D Microwave and UHF wave exciting systems (incluiding ECR, cavity resonance systems; precedence)} including systems generally using microwaves) H01L 21/302 101 E Local plasma (including atmospheric discharge, PACE, chemical vapor machining H01L 21/3046 {using blasting, e.g. sand-blasting (H01L 21/2633 takes precedence)} HO1L 21/302 101 F Wafer lamination batch processing systems (including barrel, etching tunnel systems) FIと比較して、CPCは分類数が少ない systems (including substrate cooling mechanisms, heating HO1L 21/302 101 H System cleaning (including wall cleaning, aging) HO1L 21/302 101 M Improvemnet of maintenability (technology necessary for disassembly and cleaning of systems and replacement of consumable parts) H01L 21/302 101 L Mateial of electrodes (including inventions for designating electrode materials such as glassy carbons or describing electrode formation methods) HO1L 21/302 101 R Back side gas supply (including technologies for supplying thermally conductive gas to the portion that will closely cotact back face of treated substrate to improve thernal H01L 21/302 101 Z Others · · · · · · Substrate cleaning (plasma clenaing including substrate surface cleaning; plasma cleaning H01L21/302 and 106) · · · · · · End point detection and monitoring (for etching end poin detection troscopic analysis, mass detection, detected waveform

この分類は、FIが優位





JIPAの発表内容(2014年度)

- ◆ CPCとFIの階層構造の比較
 - CPCが優位(分類数が多い)の技術分野

< APPENDIX 2> Analysis for B41J2(Ink Jet Printer)

```
CPC entry -> 220
  B41J 2/01 . . Ink jet
                                                                                            B41J 3/00 101
                                                                                                            · Recording head
  B41J 2/015 . . . characterised by the jet generation process (B41J 2/21
                                                                                            B41J 3/00 102

    Recording device drive

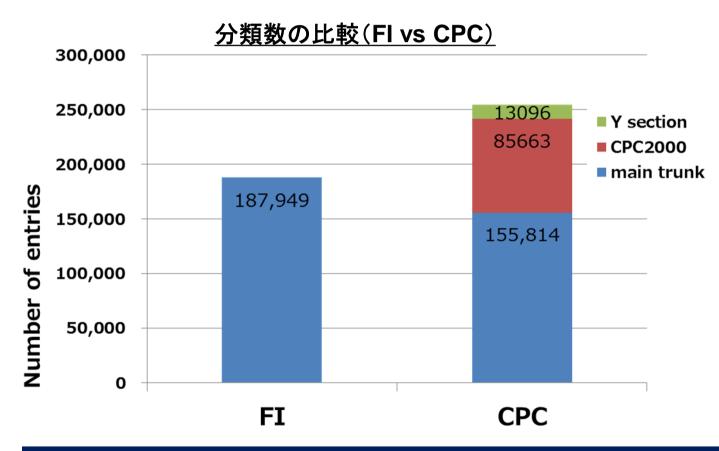
  B41J 2/02
                 . . generating a continuous ink jet
                                                                                                              for building-up characters by writing or by
  B41J 2/025
                 . . . . by vibration
                                                                                                             · · by moving styli or their equivalent or writing iets
  B41J 2/03
  B41J 2/035
                 CPCの分類数の方がFIより多い。FIは旧IPCを基本としている。
  B41J 2/04
  B41J 2/045
  B41J 2/04501
                           Control methods or devices therefor, e.g. driver
                                                                                            B41J 3/04 101 Z Others
  B41J 2/04503
                                                                                            B41J 3/04 102
                                                                                                            · · · Ink supply device
                           { aiming at compensating carriage speed}
  B41J 2/04505 . . . . . .
                                                                                            B41J 3/04 102 N Nozzle drving prevention
                            aiming at correcting alignment)
  B41J 2/04506
                                                                                            B41J 3/04 102 H Head cleaning
                            aiming at correcting manufacturing tolerances)
  B41J 2/04508
                           aiming at correcting other par
                                                                                             B41.1.3/04.102 R Unnecessary ink collection
                                                                                                            Others
  B41J 2/0451 ...
                         { for detecting failure, e.g. cloggi
                                                                                                             · · · · Ink particle forming device
  B41J 2/04511
                       ... { for electrostatic discharge pr
                                                                                                            Pressure control systems in general
  B41J 2/04513 .
                          { for increasing lifetime}
                                                                                             B41J 3/04 103 B • Bubble iet (R) type
  B41J 2/04515.
                          { preventing overheating}
                                                                                            B41J 3/04 103 D • Diaphragm type
B41J 3/04 103 C using air flow
B41J 3/04 103 E Vibration control system (continuous type)
  B41J 2/04516.
                      .... { preventing formation of satellite drops}
  B41J 2/04518.
                          { reducing costs}
  B41J 2/0452 ...
                         { reducing demand in current or voltage}
                                                                                            B41J 3/04 103 F Stylus system using a magnetic fluid
  B41J 2/04521
                          { reducing number of signal lines needed}
                                                                                            B41J 3/04 103 G Electrostatic or magnetic suction system
  B41J 2/04523
                           reducing size of the apparatus
                                                                                            B41J 3/04 103 S using thermally fused ink (solid ink)
B41J 3/04 103 T (using the ink carrier such as the porous sheet
  B41J 2/04525 .
                          { reducing occurrence of cross talk}
                                                                                        21 B41J 3/04 103 H Head assembly or manufacture
  B41.L2/04526
                           { controlling trajectory}
  B41J 2/04528.
                        .. { aiming at
                                                              この分類はCPCが優位!
                                                                                            B41.L3/04 104 B Electrical field control type
                                                                                            B41J 3/04 104 C Phase search or control (takes precedence over F.)
                                                                                            B41J 3/04 104 D Flving control against relative moving between the
                                                                                            B41J 3/04 104 F Flving control using feedback control
                                                                                            B41J 3/04 104 G Flving control using distortion correction
                                                                                            B41J 3/04 104 H Flying control characterized by processing of the dot
                                                                                            B41.L3/04 104 F Charging or deviation electrode
B41J 2/2132 . . . . { Print quality control characterised by dot disposition
                                                                                            B41J 3/04 104 K Detection electrode or detection device
B41J 2/2135 . . . . { Alignment of dots (adjustments by bodily moving pri
                                                                                            B41J 3/04 104 X Flving control for concentration or gradation
                                                                                        36 B41J 3/04 104 Z Others
B41J 2/2139 . . . . { Compensation for malfunctioning nozzles creating
B41J 2/2142 . . . . { Detection of malfunctioning nozzles (for cleaning p
B41J 2/2146 . . . . { for line print heads}
```





分類数の比較 (FI vs CPC)

◆ 主要部分の分類数は、ほぼ同じ







CPCとFIのコンコーダンス表の作成

- ◆ CPC→IPC(CPC サイトより)、FI→IPC(JPOサイトより)コンコーダンス表を元に、同じIPCをキーとして、コンコーダンス表を作成した
 - このコンコーダンス表を用い、FIとCPCの階層の違いを検証した

1	FI	(分類数) IPC 0 A61 B	(Fy	PC 熱プローブまたは熱吸収体を熱	CPC A61 B1 8/28:	G H (分類数)
5280	A61 B 19/00 ¥; A61 B 19/00 501 ¥; A61 B 19/00 502 ¥; A61 B 19/00 503 ¥; A61 B 19/00 506 ¥; A61 B 19/00 507 ¥; A61 B 19/00 508 ¥; A61 B 19/00 509 ¥; A61 B 19/00 510 ¥; A61 B 19/00 511 ¥; A61 B 19/00 512 ¥; A61 B 19/00 513 ¥; A61 B 19/00 514 ¥;	15 A61 B		置, 傷口保護具のためのもの (保護用の顔面マスクA41D13 /11; 外科医または患者用のガ ウンまたは衣類A41D13/12; 体液を除去, 処理または導入す る用具A61M1/00)	A61 B19/00; A61 B19/20; A61 B19/201; A61 B19/203; A61 B19/22; A61 B19/223; A61 B19/24; A61 B19/26; A61 B19/28; A61 B19/30; A61 B19/36; A61 B19/36; A61 B19/36; A61 B19/40; A61 B19/42; A61 B19/44; A61 B19/46; A61 B19/46; A61 B19/50; A61 B19/52;	191

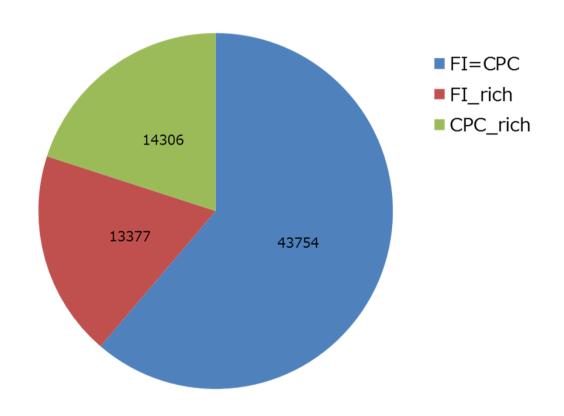




CPCとFIの分類数の大小比較

◈ 階層が異なる範囲は半数以下

同じIPC配下(サブグループ以下)でのCPCとFIの分類数を比較



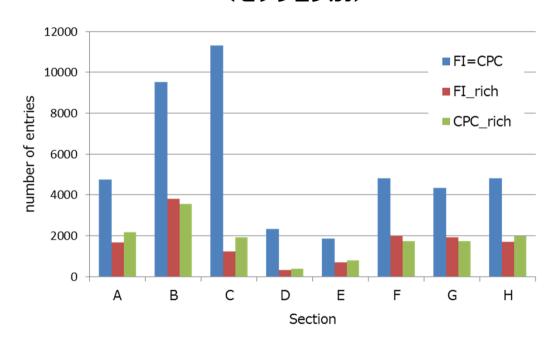




CPCとFIの分類数の大小比較(セクション別)

◆ Cセクション、Dセクションは、「CPCとFIの分類数が同じ」割合が多い。

同じIPC配下(サブグループ以下)でのCPCとFIの分類数を比較 <セクション別>

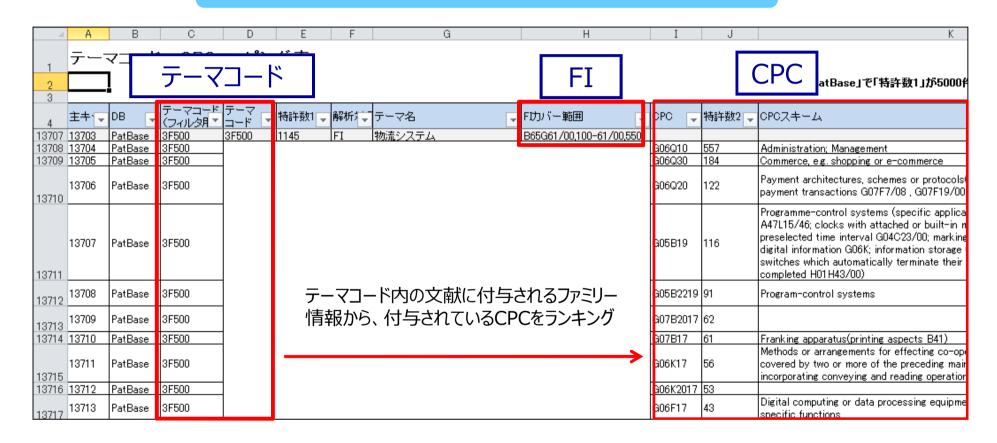






テーマコードとCPCのマッピング表

FIと付与観点が異なる場合のCPCを確認する事ができる



テーマコード:3F500

物流システム

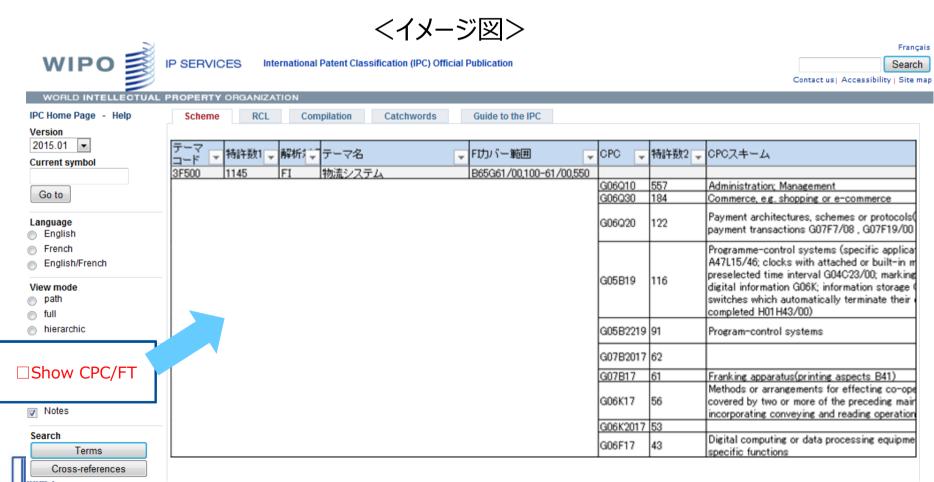
FI:B65G61/00,100-61/00,550 サプライチェーン・マネジメント (SCM) に関するもの





テーマコードとCPCのマッピング表

PATENTSCOPEの「IPC / CPC / FI Parallel Viewer」 機能にテーマコードとCPCのマッピング表の追加を要望



ご清聴有難うございました





